

# 2022-2028年中国半导体市场深度研究与前景趋势报告

## 报告目录及图表目录

中国产业研究报告网 编制

[www.chinairr.org](http://www.chinairr.org)

## 一、报告报价

《2022-2028年中国半导体市场深度研究与前景趋势报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.chinairr.org/report/R06/R0601/202111/20-437100.html>

产品价格：纸介版9800元 电子版9800元 纸介+电子10000元

订购电话: 400-600-8596 010-80993936

传真: 010-60343813

网址: <http://www.chinairr.org>

Email: [sales@chyxx.com](mailto:sales@chyxx.com)

联系人：刘老师 陈老师 谭老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

中国产业研究报告网发布的《2022-2028年中国半导体市场深度研究与前景趋势报告》共十章。首先介绍了半导体相关概念及发展环境，接着分析了中国半导体规模及消费需求，然后对中国半导体市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国半导体面临的机遇及发展前景。您若想对中国半导体有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

### 第一部分 基础篇

#### 第一章 半导体产业概述

##### 1.1 全球半导体产业概述

###### 1.1.1 全球半导体产业发展历程

###### 1.1.2 全球半导体产业景气循环

###### 1.1.3 半导体产业在现代国民经济中的重要地位

###### 1.1.4 半导体产业关联度分析

##### 1.2 中国半导体产业概述

###### 1.2.1 中国半导体产业发展历程

###### 1.2.2 中国半导体产业市场概述

##### 1.3 半导体产业链结构

##### 1.4 半导体产品分类

##### 1.5 半导体制造流程

##### 1.6 半导体集成电路类别

### 第二章 全球及中国半导体市场分析

#### 2.1 全球半导体市场分析

##### 2.1.1 全球半导体市场分析

##### 2.1.2 全球半导体应用领域分析

- 2.1.3 全球半导体资本支出分析
- 2.1.4 全球半导体产能分析
- 2.1.5 2021年全球半导体主要厂商排名
- 2.1.6 2021年全球主要半导体厂商投资分析
- 2.2 2017-2021年中国半导体市场分析

## 第二部分 产业链篇

### 第三章 全球及中国IC设计市场分析

#### 3.1 IC设计行业概述

##### 3.1.1 IC设计行业特点

##### 3.1.2 IC设计流程

##### 3.1.3 IC设计方法演进路线

##### 3.1.4 SOC主要特性及关键技术

##### 3.1.5 IC设计业务模式

##### 3.1.6 IC设计竞争力影响因素

#### 3.2 全球及中国IC设计行业发展概述

##### 3.2.1 全球IC设计行业发展概述

##### 3.2.2 中国IC设计行业发展概述

#### 3.3 中国IC设计业SWOT分析

##### 3.3.1 中国IC设计业优势（S）

##### 3.3.2 中国IC设计业劣势（W）

##### 3.3.3 中国IC设计业威胁（T）

##### 3.3.4 中国IC设计业机会（O）

#### 3.4 中国IC设计行业分市场分析

##### 3.4.1 中国消费类IC设计市场分析

##### 3.4.2 中国通信IC设计市场分析

##### 3.4.3 中国工业控制类IC设计市场分析

#### 3.5 中国IC设计厂商分析

##### 3.5.1 大唐微电子

##### 3.5.2 杭州士兰

##### 3.5.3 中星微

##### 3.5.4 珠海炬力

- 3.5.5 中国华大
- 3.5.6 南山之桥
- 3.5.7 北京北大众志
- 3.5.8 北大青鸟集成电路
- 3.5.9 北京海尔集成电路
- 3.5.10 北京华虹集成电路
- 3.6 中国IC设计投资分析

#### 第四章 全球及中国IC制造市场概述

- 4.1 2017-2021年全球IC制造市场概述
- 4.2 2017-2021年中国IC制造市场概述
- 4.3 全球及中国主要IC制造厂商分析
  - 4.3.1 全球主要IC制造厂商
    - 4.3.1.1 台积电
    - 4.3.1.2 台联电
    - 4.3.1.3 新加坡特许半导体
  - 4.3.2 中国主要IC制造厂商
    - 4.3.2.1 中芯国际
    - 4.3.2.2 华虹
    - 4.3.2.3 上海宏力
    - 4.3.2.4 上海新进
    - 4.3.2.5 江苏和舰
    - 4.3.2.6 上海先进
    - 4.3.2.7 珠海南科
    - 4.3.2.8 中纬积体
    - 4.3.2.9 首钢日电
    - 4.3.2.10 华越微电子
- 4.4 全球四大晶圆厂对比分析
  - 4.4.1 全球四大晶圆代工厂经营状况比较
  - 4.4.2 全球四大代工厂商代工厂比较
- 4.5 小结

## 第五章 2017-2021年全球及中国IC封测市场分析

### 5.1 IC封测概述

#### 5.1.1 IC封测概述

#### 5.1.2 主要IC封装技术比较

#### 5.1.3 IC封装发展趋势

### 5.2 全球IC封测概述

### 5.3 中国IC封测概述

### 5.4 中国主要IC封测厂商

#### 5.4.1 江苏长电

#### 5.4.2 北京自动测试技术研究所

#### 5.4.3 南通富士通微

#### 5.4.4 华越芯装

#### 5.4.5 乐山菲尼克斯

#### 5.4.6 宁波明昕

#### 5.4.7 天水华天

#### 5.4.8 北京微电子技术研究所

## 第六章 全球及中国半导体设备市场分析

### 6.1 半导体设备行业概述

### 6.2 世界半导体设备市场分析

### 6.3 中国半导体设备市场分析与预测

### 6.4 中国半导体二手设备市场分析

### 6.5 中国半导体设备主要厂商分析

#### 6.5.1 七星华创

#### 6.5.2 铜陵三佳电子

#### 6.5.3 中电45所

#### 6.5.4 中电48所

#### 6.5.5 西北机器厂

#### 6.5.6 兰州兰新

#### 6.5.7 北京中科信

#### 6.5.8 沈阳芯源

#### 6.5.9 青岛旭升

#### 6.5.10 商巨科技

### 第七章 全球半导体原材料市场分析

#### 7.1 半导体原材料行业概述

#### 7.2 全球半导体原材料市场分析

#### 7.3 中国半导体原材料市场分析

#### 7.4 中国半导体原材料主要厂商分析

##### 7.4.1 有研硅股

##### 7.4.2 上海合晶

##### 7.4.3 万向硅峰

##### 7.4.4 宁波立立

##### 7.4.5 洛阳单晶硅

##### 7.4.6 峨嵋半导体

##### 7.4.7 浙大海纳

##### 7.4.8 国瑞电子材料有限公司

##### 7.4.9 北京化学试剂研究所

##### 7.4.10 中电华威

### 第三部分 发展篇

### 第八章 中国半导体产业区域分析

#### 8.1 长江三角洲

##### 8.1.1 上海

##### 8.1.2 江苏

##### 8.1.3 浙江

#### 8.2 京津环渤海湾

##### 8.2.1 北京

##### 8.2.2 河北

##### 8.2.3 山东

##### 8.2.4 辽宁

##### 8.2.5 天津

#### 8.3 珠江三角洲

##### 8.3.1 深圳

## 8.4 西部地区

### 8.4.1 西安

### 8.4.2 四川

### 8.4.3 重庆

## 第九章 中国半导体产业环境分析

### 9.1 中国半导体产业投融资环境分析

### 9.2 中国半导体产业政府政策分析

#### 9.2.1 全球主要国家半导体产业政策分析

#### 9.2.2 中国半导体产业政策分析

### 9.3 中国硅知识产权（IP）产业分析

#### 9.3.1 IP产业概述

#### 9.3.2 IP基本概念与相关流程

#### 9.3.3 IP市场前景分析

#### 9.3.4 中国IP行业存在的主要问题

#### 9.3.5 中国IP行业新进展

#### 9.3.6 中国IP产业调查

#### 9.3.7 小结

## 第十章 执行总结

### 图表目录：

图表 1 2017-2021年我国单晶硅材料供应分析

图表 2 2017-2021年我国氮化镓材料供应分析

图表 3 2017-2021年全球半导体行业总体规模

图表 4 2017-2021年全球集成电路行业总体规模

图表 5 2017-2021年全球半导体分立器件行业总体规模

图表 6 2017-2021年全球光电子器件行业总体规模

图表 7 英特尔经营情况分析

图表 8 德州仪器经营情况分析

图表 9 高通经营情况分析

图表 10 飞思卡尔经营情况分析



图表 11 AMD经营情况分析  
图表 12 亚德诺半导体技术公司经营情况分析  
图表 13 2021年日本电气股份有限公司经营情况分析  
图表 14 2021年东芝经营情况分析  
图表 15 意法半导体经营情况分析  
图表 16 2021年三星电子经营情况分析  
图表 17 2017-2021年我国半导体产业市场总规模分析  
图表 18 2017-2021年我国集成电路产业市场总规模分析  
图表 19 2017-2021年我国分立器件产业市场总规模分析  
图表 20 idm商业模式  
图表 21 垂直分工商业模式  
图表 22 IP市场的收费模式  
图表 23 IP核的硅验证及SOC验证  
图表 24 2017-2021年我国集成电路设计行业发展规模分析  
图表 25 2017-2021年我国集成电路制造行业发展规模分析  
图表 26 2017-2021年我国集成电路封测行业发展规模分析  
图表 27 2017-2021年我国集成电路行业企业数量分析  
图表 28 2017-2021年我国集成电路行业资产规模分析  
图表 29 2017-2021年我国集成电路行业销售收入分析  
图表 30 2017-2021年我国集成电路行业利润总额分析  
更多图表见正文&hellip;&hellip;

详细请访问：<http://www.chinairr.org/report/R06/R0601/202111/20-437100.html>